



桥接技术

FTDI Chip 专注于协助客户实现“桥接技术”

我们的目标与愿景:

立志成为无晶圆半导体行业举足轻重的角色

- 以领先的科技与持续高效的商业盈利模式，提供可行的解决方案
- 提供产品解决方案以缩短客户的开发与产品上市时间，并藉由优良的技术支援，提升宏观成本效益
- 立志成为全球客户首选的 IC 解决方案伙伴
- 提供精心设计的产品组合，以满足客户全球布局的管理需求
- 开发出简单易用的软硬体，产品手册和应用支援服务，促进客户的产品开发进度
- 持续设计发展新颖的 FTDI 芯片，协助客户快速整合至产品系统
- 持续精进管理效益
- 确保产品与服务，于承诺的时效内，精确的交付客户
- 确保客户所收到的产品经过全面测试和良好的包装，并避免在运输过程中损坏

Quality Policy approved by

A handwritten signature in blue ink, reading "Cathy Dart".

Cathy Dart, COO

April 2025